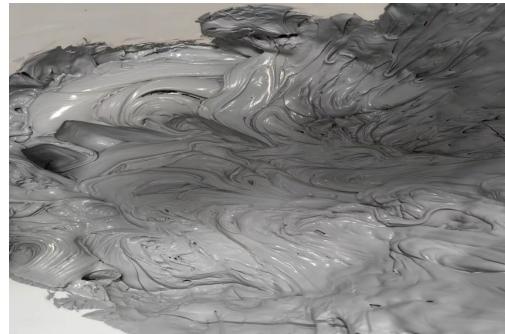


## 超低热阻导热硅脂

TG600-M是一款具有超低热阻系数的导热硅脂。该产品同时具备低BLT热阻和高导热系数，可以有效降低散热器及发热源之间的接触热阻，旨在满足当前以及未来的热管理要求，该类型的高导热硅脂已成功应用于CPU、GPU、PLC等温度敏感元件。



### 特性和优点

- 导热系数6.0W/(m·K)
- 含金属填料颗粒（需注意）
- 低游离度
- 长效性、可靠性佳
- 接触面湿润性佳，有效降低界面热阻

### 典型应用

- IT-笔记本、服务器、电脑、存储模组
- 网络通讯装备—无线模块、路由器
- 消费类电子—游戏系统、便携设备
- 工业工控设备
- 电源
- 高功率LED照明

典型属性		
属性	典型值	测试方法
颜色	灰色	目视
密度(g/cc)	2.6	ASTM D792
挥发份(%)	≤0.5	@150°C/24h
粘度(cP)	386000	DV2T-T96-12Rpm
锥入度(0.1mm @25°C)	253	GB/T269
耐温范围(°C)	-40~150	/
保质期(月)	12	温度<40°C避免挤压、暴晒
导热性能		
导热系数(W/(m·K))	6.0	ISO 22007-2
热阻(°C·in <sup>2</sup> /W @50psi,80°C)	≤0.008	ASTM D5470